(2) Japanese Patent Application Laid-Open No. 11-274271 (1999): "SUBSTRATE PROCESSING APPARATUS"

The following is a brief description relevant to the present invention.

After performing processing such as a liquid chemical processing on a substrate in second substrate transport areas 18 and 19, a wafer W is transported to a dry bath 25 by a transport mechanism 9 in a first substrate transport area 20 outside the second substrate transport areas 18 and 19. As such, because the wafer needs to be transported before being dried to the first substrate transport area 20 near the outside containing oxygen, the wafer is likely to be affected by an external atmosphere as compared with the present invention.

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-274271

(43)公開日 平成11年(1999)10月8日

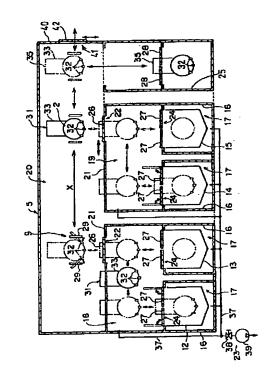
(51) Int.Cl.6		識別記号		ΡI				
HO1L	21/68			H01L 2	1/68		D	
G02F	1/00			G02F	1/00			
	1/13	101			1/13		101	
	1/1333	5 O O			1/1333		500	
H01L	21/304	648		H01L 2	1/304		648J	
			審査請求	未請求 請求事	画の数5	OL	(全 13 頁) 最終頁に続く
				<u> </u>			·	
(21)出願番	身	特顏平10-75540		(71) 出顧人				
							ーン製造株式	
(22)出願日	•	平成10年(1998) 3月24日		京都府	京都市	上京区堀川	通寺之内上る4丁	
		•			日天神	北町1	番地の1	
			(72)発明者	長谷川 公二				
					滋賀県	野洲郡	野洲町大字	三上字ロノ川原
					2426番	1 大	日本スクリ	ーン製造株式会社
					野洲事	業所内		
				(74)代理人	弁理士	小谷	悦司 (外2名)
					-	•		

(54) 【発明の名称】 基板処理装置

(57)【要約】

【課題】 排気手段をより小型化して省電力で省スペー スの基板処理装置を提供する。

【解決手段】 薬液からのヒュームが拡散してくる各処 理部側の第2基板搬送エリア18,19をそれぞれ分離 部材としての搬送エリア外郭部材21でそれぞれ覆うと 共に、各搬送エリア外郭部材21の開口22から薬液の ヒュームが外側の第1基板搬送エリア20内に拡散し難 いように、水洗槽13,14にそれぞれ対応した位置に のみ開口22を設けて、できる限り小さな開口22とし たため、排気手段23の排気能力を大幅に小さくして も、各搬送エリア外郭部材21の外側の第1基板搬送エ リア20へのヒュームの拡散が防止可能であることか ら、排気手段23がより小型化可能で省電力で省スペー ス、しかも、より静音の基板処理装置とすることができ



2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一または複数の基板に対して所定の処理 を行う基板処理装置において、

所定方向に配列された複数の処理部と、

前記複数の処理部の少なくとも2つの処理部間で基板を 搬送させるために、前記複数の処理部の上方に設置され た搬送路と、

前記搬送路において、前記複数の処理部の少なくとも2 つの処理部間で基板を搬送させる搬送手段と、

前記搬送路の空間とその上方の位置との間で雰囲気を分離するために、前記搬送路の上方に配設され、かつ前記上方の位置と前記搬送路との間における前記搬送手段の移動を許容するための開口が形成された分離部材と、

前記搬送路内の雰囲気を排気する排気手段と、

を備えたことを特徴とする基板処理装置。

【請求項2】 前記分離部材の基板搬送用の開口に対して開閉可能なシャッタ手段を備えたことを特徴とする請求項1に記載の基板処理装置。

【請求項3】 請求項1または2に記載の基板処理装置であって、

前記複数の処理部は、基板に対して薬液処理を行う薬液 処理部と、基板に対して水洗処理を行う水洗処理部とを 含み、

前記分離部材の基板搬送用の開口は、前記分離部材における、前記水洗処理部の上方に対応した位置に形成されたことを特徴とする基板処理装置。

【請求項4】 請求項1~3の何れかに記載の基板処理 装置であって、

前記排気手段は、前記処理部のうち薬液処理部の近傍に その排気口が設けられたことを特徴とする基板処理装 置。

【請求項5】 請求項1~4の何れかに記載の基板処理 装置であって、

前記排気手段は、前記分離部材の基板搬送用の開口に対して開閉可能なシャッタ手段の開位置と閉位置に応じて高排気出力と低排気出力に切り換え制御を行う制御手段を備えたことを特徴とする基板処理装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体ウエハや液 40 晶表示パネル用ガラス基板などの薄板状の基板に所定の処理を行う基板処理装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、半導体ウエハや液晶表示パネル用 ガラス基板などを用いた精密電子基板の製造プロセスに おいては、基板を処理液に浸漬して種々の表面処理を施 している。このような表面処理においては、エッチング 液などの薬液を貯留した薬液槽とリンス液である純水を 貯留した水洗槽とを有し、薬液槽さらに水洗槽に順次基 板を浸漬して、薬液槽にて基板に薬液処理を施した後 に、さらに、水洗槽にて基板に付着した薬液やパーティ クルを洗い流すリンス処理を施している。

【0003】図5は、従来の基板処理装置における要部の概略構成を示す模式図である。

【0004】図5において、基板処理装置51は、複数の基板を一括して処理する装置であって、カセットに所定枚数がセットされた基板を装置外部との間で受渡しをする搬出入部(図示せず)から基板を受け取って搬送すると共に搬出入部(図示せず)に基板を受渡す搬送部52と、この搬送部52から基板を受け取って基板に所定の処理を施すと共に、その処理後の基板を搬送部52に受け渡す各処理ユニット53とを有している。

【0005】この搬送部52は、上下の各搬送路にそれぞれ配設され各処理ユニット53の配設方向(X方向)にそれぞれ移動する2つの搬送ロボット52a,52bを備えている。これらの搬送ロボット52a,52bはそれぞれ、各処理ユニット53の配設方向(X方向)と図5の紙面に直交する方向(図7のY方向)に伸びる軸部材54a(図6)を介して取り付けられた保持板54をそれぞれ一対有し、これらの一対の保持板54の内側の保持用溝(図示せず)で、起立姿勢の複数の基板55がY方向に並べられた状態でそれらの両側端面を両側からそれぞれ挟み込んで各保持用溝で受けて保持するようになっている。

【0006】また、各処理ユニット53は、エッチイング液などの薬液を貯留した薬液槽56と、この薬液槽56による処理済みの基板55に付いた薬液やパーティクルなどを水洗する水洗槽57と、薬液を貯留した薬液槽58と、この薬液槽58による処理済みの基板55に付いた薬液やパーティクルなどを水洗する水洗槽59と、この水洗槽59で水洗処理された基板55を乾燥する乾燥槽60とを有している。これらの薬液槽56、水洗槽57、薬液槽58さらに水洗槽59にわたって複数の基板55を一括して順次浸漬させることにより基板55に薬液処理や水洗処理などの一連の各種処理が施され、さらにその処理後の基板55を乾燥させるようになっている。

【0007】さらに、これらの薬液槽56,58および水洗槽57,59の各処理槽にはそれぞれリフタ装置61が配設されており、各リフタ装置61はそれぞれ複数の基板55を載置可能であると共に処理槽内と基板受渡位置の間で上下移動自在に構成されている。また、これらの薬液槽56,58および水洗槽57,59の各処理槽にはそれぞれ外郭部材62がそれぞれ配設されており、これらの外郭部材62と乾燥槽60の上面部にはそれぞれ、各処理槽の上部開放口に対向するように基板導入口を開閉自在な開閉扉63が配設されている。これらの開閉扉63はそれぞれ通常は閉じており、リフタ装置61の処理槽内への下降に連動して両側に開くように構

成されていると共に、処理槽内からの上昇に連動して両 側に開くように構成されている。

【0008】これらの各外郭部材62の適所にはそれぞれ排気ダクト64が開口しており、その排気ダクト64は流量調整バルブ65を介して排気ポンプ66に連通されている。これらの排気ダクト64、流量調整バルブ65および排気ポンプ66によって排気手段が構成されており、この排気手段による外郭部材62内の排気によって、外郭部材62の基板導入口の開閉扉63が開いても、この基板導入口から外部空気が流入することで、この基板導入口を介して薬液槽56,58からのヒューム(酸やアルカリなどが混ざった雰囲気)の外部への拡散を防止するようになっている。

【0009】さらに、図6に示すように、リフタ装置6 1と例えば搬送ロボット52bとは、並んで配設(図6 の紙面に垂直な図5のX方向)された複数の処理槽をそれらの幅方向に両側から挾んで対向した状態で配設されている。また同様に、リフタ装置61と例えば搬送ロボット52aについても、並んで配設(図6の紙面に垂直な図5のX方向)された複数の処理槽をそれらの幅方向20に両側から挾んで対向した状態で配設されている。

【0010】上記構成により、まず、搬送ロボット52 bは、搬出入部(図示せず)から基板を受け取って各処 理ユニット53の薬液槽56の上方の基板受渡位置まで その配設方向(X方向)に沿って搬送する。このとき、 図6に示すように、搬送ロボット52bの一対の保持板 54は、それらの内側の複数の保持用溝で、起立姿勢の 複数の基板55の両側端面を両側からそれぞれ挾み込ん で受けて保持している。これに対して、薬液槽56のリ フタ装置61が上昇してきて、その下方部に設けられた 30 3つの保持アーム61a上側の複数の各保持溝で、搬送 ロボット52bに保持されている複数の基板を下方から 受ける。その後、搬送ロボット52bの一対の保持板5 4をそれぞれ実線で示すような垂直方向になるように回 動させて、搬送ロボット52bの複数の基板55への保 持を解除し、リフタ装置61への複数の基板55の受渡 しを完了する。

【0011】次に、リフタ装置61は複数の基板を3つの保持アーム61a上側の複数の各保持溝で保持した状態で薬液槽56内に向けて下降する。この下降に連動して外郭部材62の開閉扉63が仮想線のように両側に起立して開き、薬液槽56の上部開放口から複数の基板55を保持した保持アーム61aをその薬液中に浸漬させて所定時間放置することで複数の基板55に所定の薬液処理を施す。このとき、開閉扉63は閉じられており、この薬液槽56は外郭部材62で略密閉されている。また、外郭部材62内は排気ポンプ66によって排気ダクト64を介して排気されている。

【0012】さらに、リフタ装置61は、所定時間後、 薬液処理後の複数の基板55を上昇させ、それに連動す るように開閉扉63が仮想線のように両側に起立して開き、薬液槽56の上部開放口から複数の基板55を保持した保持アーム61aを薬液槽56の上方の基板受渡位置まで上昇させる。その基板受渡位置では、搬送ロボット52bが一対の保持板54をそれぞれ垂直方向にした状態で待機しており、複数の基板55を保持した保持アーム61aを基板受渡位置に到着させた後に、一対の保持板54の下部側をそれぞれ内側に回動させて、複数の基板55の両側端面を両側からそれぞれ挾み込んで一対の保持板54の各保持用溝で受けて保持する。

【0013】さらに、リフタ装置61を保持アーム61 aと共に下方に退避させて一対の保持板54に基板55 を移し代えた後に、搬送ロボット52bは複数の基板5 5を、薬液槽56の隣に位置している水洗槽57の上方 の基板受渡位置までその配設方向(X方向)に沿って搬 送する。このとき、搬送ロボット52bの一対の保持板 54はそれぞれ、それらの内側の複数の保持用溝で、起 立姿勢の複数の基板55の両側端面を両側からそれぞれ 挾み込んで受けて保持している。これに対して、水洗槽 57のリフタ装置61が上昇してきて、その下方部に設 けられた3つの保持アーム61aの上側の複数の各保持 溝で、搬送ロボット52bに保持されている複数の基板 55を下方から受ける。その後、搬送ロボット52bの 一対の保持板54をその長手方向が垂直方向になるよう にそれぞれ回動させて、搬送ロボット52bの複数の基 板55への保持を解除し、水洗槽57のリフタ装置61 への複数の基板55の受渡しが完了する。

【0014】さらに、水洗槽57のリフタ装置61は複数の基板55を3つの保持アーム61a上側の複数の各保持溝で保持した状態で水洗槽57内に向けて下降する。これと同時に、基板55の受渡し後の空状態の搬送ロボット52bは、搬出入部(図示せず)との基板受渡位置までその配設方向(X方向)に沿って移動し、その搬出入部から複数の基板55の受渡しに備える。

【0015】このリフタ装置61の下降に連動して外郭部材62の開閉扉63が開き、水洗槽57の上部開放口から複数の基板55を保持した保持アーム61aをその純水中に浸漬させて複数の基板55を水洗処理する。この水洗処理時には、その開閉扉63は閉じられており、この水洗槽57の外郭部材62内が密閉されている。

【0016】さらに、リフタ装置61は、所定時間後、水洗処理後の複数の基板55を上昇させ、それに連動するように開閉扉63が開き、水洗槽57の上部開放口から複数の基板55を保持した保持アーム61aを水洗槽57の上方の搬送ロボット52a用の上側の基板受渡位置まで上昇させる。その基板受渡位置では、搬送ロボット52aが一対の保持板54の長手方向を垂直方向にした状態で待機しており、複数の基板55を保持した保持アーム61aをその基板受渡位置に到着させた後に、一対の保持板54の下部側をそれぞれ内側に回動させて、

複数の基板55の両側端面を両側からそれぞれ挟み込んで各保持用溝で受けて保持することで、複数の基板55 の受渡しを行う。

【0017】その後、搬送ロボット52aは、乾燥槽60へ複数の基板55を搬送して乾燥槽60で複数の基板55に乾燥処理を施す。また、搬送ロボット52bは、各処理槽のリフタ装置61との複数の基板55の受渡しを行いつつ、以上と同様の動作を繰り返して薬液槽56さらに水洗槽57による一連の処理を行うように複数の基板55を搬送する。

【0018】さらに、乾燥処理後の複数の基板55を乾燥槽60のリフタ装置61から受け取った搬送ロボット52aは、搬出入部(図示せず)との基板受渡位置までその配設方向(X方向)に沿って複数の処理済みの複数の基板55を搬送して、搬出入部に複数の処理済みの複数の基板55を受け渡す。

[0019]

【発明が解決しようとする課題】ところが、上記従来の構成では、各処理槽に対してリフタ装置61が複数の基板55を載置した状態で上昇または下降するときに、それに連動して外郭部材62の基板導入口の開閉扉63が開くが、このとき、基板導入口を介して薬液槽56,58からのヒュームが、搬送ロボット52a,52bとリフタ装置61との受渡位置を含む基板搬送ラインにまで拡散しないように、薬液槽56,58および水洗槽57,59をそれぞれ覆う各外郭部材62内の雰囲気をそれぞれ、基板導入口からヒュームが拡散しない程度の風速で空気が内部に入り込んでくるように排気する排気手段を設けている。この排気手段の排気能力は、かなり多量の排気量/時間が必要となって多くの駆動電力を必要とすると共に、排気手段自体も大型化して嵩ばるという問題を有していた。

【0020】因みに、ヒュームが基板搬送ラインにまで拡散してしまうと、ヒュームによって水洗処理後の綺麗な基板も汚れ、これがデバイスのロット不良を引き起こすと共に、ヒュームによる腐食によって機械構造系の部品不良を引き起こしたり、クリーンルーム内の清浄な空気を汚したりしてしまう。

【0021】本発明は、上記従来の問題を解決するもので、排気手段をより小型化して省電力で省スペースの基 40 板処理装置を提供することを目的とする。

[0022]

【課題を解決するための手段】本発明の基板処理装置は、一または複数の基板に対して所定の処理を行う基板処理装置において、所定方向に配列された複数の処理部と、複数の処理部の少なくとも2つの処理部間で基板を搬送させるために、複数の処理部の上方に設置された搬送路と、搬送路において、複数の処理部の少なくとも2つの処理部間で基板を搬送させる搬送手段と、搬送路の空間とその上方の位置との間で雰囲気を分離するため

に、搬送路の上方に配設され、かつ上方の位置と搬送路

との間における搬送手段の移動を許容するための開口が 形成された分離部材と、搬送路内の雰囲気を排気する排 気手段とを備えたことを特徴とするものである。

6

【0023】この構成により、薬液等からのヒュームが拡散してくる搬送路を分離部材で覆うと共に、その分離部材の開口から薬液のヒュームが外側に拡散し難いように、一の処理部に対応した位置にのみ開口を設けて、できる限り小さな開口としたので、排気手段の排気能力が大幅に小さくなっても、分離部材の外側へのヒュームの拡散が防止可能であることから、排気手段がより小型化可能で省電力で省スペース、しかも、より静音の基板埋装置となる。したがって、より排気能力の小さな排気手段で、ヒュームを分離部材外部に拡散させず、従来のように水洗処理後の綺麗な基板が汚染されるようなこともなく、デバイスのロット不良を引き起したり、ケリーンルーム内の清浄な空気を汚したりする不都合も解消される。

【0024】また、好ましくは、本発明の基板処理装置 において、分離部材の基板搬送用の開口に対して開閉可 能なシャッタ手段を備える。

【0025】この構成により、基板搬送用の開口が分離 部材に必要となるが、この分離部材の開口を開閉するシャッタ手段を設ければ、排気能力がより小さい排気手段 で、薬液から出たヒュームの分離部材外部への拡散が防止可能となる。

【0026】さらに、好ましくは、本発明の基板処理装置における複数の処理部は、基板に対して薬液処理を行う薬液処理部と、基板に対して水洗処理を行う水洗処理部とを含み、分離部材の基板搬送用の開口は、分離部材における、水洗処理部の上方に対応した位置に形成される。

【0027】この構成により、薬液の付いた基板が基板処理エリアから外側に取り出される薬液処理部の上方位置が最もヒューム濃度が濃く、そのヒューム濃度の濃い位置から離れた水洗処理部の上方の分離部材に開口があれば、薬液から出たヒュームが外側に拡散されにくく、排気能力のより小さい排気手段で済むことになる。

【0028】さらに、好ましくは、本発明の基板処理装置における排気手段は、処理部のうち薬液処理部の近傍にその排気口を設ける。

【0029】この構成により、薬液処理部の上方位置が最もヒューム濃度が濃く、薬液処理部の近傍に排気口を設けるようにすれば、排気手段で排気口からヒューム濃度の濃い雰囲気を効率よく排気することが可能となって、排気能力のより小さい排気手段でも、よりヒューム濃度を希薄にすることが可能となる。

【0030】さらに、好ましくは、本発明の基板処理装置における排気手段は、分離部材の基板搬送用の開口に

対して開閉可能なシャッタ手段の開位置と閉位置に応じて高排気出力と低排気出力に切り換え制御を行う制御手段を備える。

【0031】この構成により、分離部材の開口がシャッタ手段によって開いているときには高排気出力で搬送路内のヒュームを排気し、分離部材の開口がシャッタ手段によって閉じているときには低排気出力で搬送路内のヒュームを排気するように切り換え可能にしたので、シャッタ手段の閉時には、省電力で小駆動音(静音)とすることが可能になると共に、シャッタ手段の開時にはヒュ 10ームの分離部材外部への拡散が大幅に抑制され得る。

[0032]

【発明の実施の形態】以下、本発明に係る基板処理装置 の実施形態について図面を参照して説明するが、本発明 は以下に示す実施形態に限定されるものではない。

【0033】図1は本発明の一実施形態の基板処理装置の概略要部構成を示す斜視図であり、図2は図1の基板処理装置のAA断面部分を背面から見た概略要部構成図である。

【0034】図1において、基板処理装置1は、ウエハ 20 などの複数の基板2を一括して処理する装置であって、カセット3に所定枚数がセットされた基板2を装置外部との間で受渡しをする搬出入部4と、この搬出入部4から処理前の基板2を受け取って搬送し、基板2に所定の処理を施すと共に、処理済みの基板2を搬送して搬出入部4に受渡す基板処理ユニット5とを有している。

【0035】この搬出入部4は、搬入された(または搬 出直前の)複数の基板2をカセット3にセットした状態 で一時的に並べて載置しておくカセット載置台6と、カ セット3の両上端つば部分3aを下方からそれぞれ受け て保持する片持ち状に2本突き出たカセット保持アーム 7が、このカセット載置台6のカセット並び方向に移動 自在であると共に、カセット保持アーム7でカセット3 を取り込んで保持したりカセット3を載置したりするた めに上下方向に昇降自在で、かつその上下方向に平行な 軸(カセット保持アーム7の取付部材を支持する支持 軸)を中心に回動自在に構成されている移載ロボット8 と、この移載ロボット8によってカセット載置台6から 載置されたカセット3内の複数の基板2だけを突き上げ て搬送機構9に受け渡す突上部10と、移載ロボット8 によって突上部10から載置された空のカセット3を洗 浄するカセット洗浄部11とを有している。この移載ロ ボット8は、カセット載置台6から突上部10の所定位 置にカセット3を搬送して載置し、突上部10でカセッ ト3から複数の基板2だけを突き上げて搬送機構9に受 け渡した後の空のカセット3をカセット洗浄部11に移 送すると共に、カセット洗浄部11で洗浄処理された空 のカセット3を、処理済みの複数の基板2が搬送機構9 から突上部10に受け渡されてカセット3内に回収され るべく、再び突上部10の位置決めされた所定位置に移 50 送して待機させるようになっている。

【0036】また、基板処理ユニット5には、図2に示 すように、複数の処理槽12~15をそれぞれ覆う各槽 外郭部材16内(処理部内)の複数の基板処理エリア1 7と、これらの複数の基板処理エリア17の上方に設け られ各基板処理エリア17間を搬送する第2搬送路を有 する2つの第2基板搬送エリア18,19と、これらの 第2基板搬送エリア18,19に対してそれぞれ基板2 を搬送する第1搬送路を有する第1基板搬送エリア20 と、これらの第2基板搬送エリア18,19と第1基板 搬送エリア20の間をそれぞれ仕切って分離する各分離 部材(雰囲気遮断部材)としての各搬送エリア外郭部材 21とが配設されている。この搬送エリア外郭部材21 の、一の処理槽(本実施形態では水洗槽)の上部開放口 に対応(対向) した上方位置には、第2基板搬送エリア 18と第1基板搬送エリア20との間および、第2基板 搬送エリア19と第1基板搬送エリア20との間を複数 の基板2が搬送可能な各開口22がそれぞれ設けられて いる。また、各基板処理エリア17内および第2基板搬 送エリア18, 19内の雰囲気を共に排気する排気手段 23が設けられている。このように、搬送エリア外郭部 材21によって仕切られた外側のクリーンな第1基板搬 送エリア20と、複数の基板2の薬液からの出し入れで ヒュームが拡散する搬送エリア外郭部材21の内側の第 2基板搬送エリア18, 19と、実際に複数の基板2を 処理する基板処理エリア17との3つのエリアに分ける と共に、基板処理エリア17内および第2基板搬送エリ ア18,19内の雰囲気を排気手段23で排気すること で、基板搬送ラインである第1基板搬送エリア20への ヒュームの拡散をより確実に防止するようになってい

【0037】つまり、本実施形態では、上記複数の処理 槽12~15は、エッチィング液などの薬液を貯留した 薬液槽12と、この薬液槽12による処理済みの基板2 に付いた薬液やパーティクルなどを洗い流す水洗槽13 と、薬液を貯留した薬液槽14と、この薬液槽14によ る処理済みの基板 2 に付いた薬液やパーティクルなどを 洗い流す水洗槽15とで構成されている。 搬送エリア外 郭部材21の一方は、薬液槽12を覆った槽外郭部材1 6と、水洗槽13を覆った槽外郭部材16とを覆うと共 に、それらの各槽外郭部材16の間(各処理部間)を基 板搬送可能な第2基板搬送エリア18をも覆うように構 成されている。また、搬送エリア外郭部材21の他方 は、薬液槽14を覆った槽外郭部材16と、水洗槽15 を覆った槽外郭部材16とを覆うと共に、それらの各槽 外郭部材16間を基板搬送可能な第2基板搬送エリア1 9をも覆うように構成されている。さらに、薬液槽1 2, 14および水洗槽13, 15の各上部開放口にそれ ぞれ対応(対向)した各槽外郭部材16の上面にはそれ ぞれ、複数の基板2を内部に導入可能な各基板導入口2

8

4がそれぞれ配設されている。これらの各基板導入口2 4のうち、水洗槽13,15側の各基板導入口24にそ れぞれ対応 (対向) する上方の各搬送エリア外郭部材 2 1の上面だけに、複数の基板2を内部に導入可能な各開 口22がそれぞれ設けられている。一方、薬液槽12, 14の各上部開放口にそれぞれ対向するようにその各上 方に基板導入口24をそれぞれ配設し、さらにその上方 の各搬送エリア外郭部材21にそれぞれ開口をそれぞれ 設けていない。これは、搬送エリア外郭部材21でエリ ア間を仕切るだけではなく、第2基板搬送エリア18, 19と第1基板搬送エリア20との連通面積(開口面 積)をより小さくして第1基板搬送エリア20へのヒュ ームの拡散を抑制すると共に、排気手段23によって第 1基板搬送エリア20へのヒュームの拡散を防止する程 度に、基板処理エリア17内および第2基板搬送エリア 18,19内の雰囲気を排気することから、その排気量 を従来とは大幅に削減可能にするためである。

【0038】また、この水洗槽15の隣側には、水洗槽 15で水洗処理された基板2を乾燥する乾燥槽25が配 設されている。薬液槽12、水洗槽13等で複数の基板 2を一括して順次各処理槽に浸漬させることにより、複 数の基板 2 に薬液処理や水洗処理などの一連の各種処理 が施され、その処理後の複数の基板2を乾燥槽25で乾 燥させるようになっている。この乾燥槽25は、所定温 度の乾燥用温風 (ヒータなどで昇温されていてもよい) が供給される構成であってもよいし、IPA(イソプロ ピルアルコール)による減圧乾燥などであってもよい。 【0039】さらに、各開口22をそれぞれスライドし て開閉する板状の開口部開閉扉26と、この開口部開閉 扉26を基板搬送に応じて開閉駆動させる開口部開閉駆 動手段(図示せず)とが搬送エリア外郭部材21の上面 部に配設されている。これらの開口部開閉扉26と開口 部開閉駆動手段によってシャッタ手段が構成されてお り、基板搬送用の開口22に対して開閉可能である。ま た、各槽外郭部材16の基板導入口24をそれぞれ開閉 する各導入口開閉扉27と、これらの各導入口開閉扉2 7を基板搬送に応じて開閉駆動させる導入口開閉駆動手 段(図示せず)とが各槽外郭部材16の上面部に配設さ れている。これらの各槽外郭部材16に各導入口開閉扉 27をそれぞれ設けているのは、単にヒュームの拡散防 止のためだけではなく液中に含まれている揮発成分の蒸 発をできるだけ抑えるためである。また、各開口部開閉 扉26を設けているのは、高クリーン度が要求される第 1基板搬送エリア20側に第2基板搬送エリア18, 1 9側からヒュームが拡散するのをできるだけ防止するた めである。この観点から、これらの各開口部開閉扉26 および各導入口開閉扉27は、複数の基板2の物流時以 外には閉じている。さらに、乾燥槽25の上面にも基板 導入口を開閉する各導入口開閉扉28が配設されてい る。

【0040】本実施形態では、この開口部開閉扉26は 搬送エリア外郭部材21の上面に沿って所定距離だけス ライドして水平移動することで開口22を開閉するよう になっており、導入口開閉扉27は両開き状に両側で回 動駆動して基板導入口24を開閉するようになってい る。これらの開口部開閉駆動手段および導入口開閉駆動 手段は例えばエアーシリンダ(図示せず)などで構成さ れていてもよい。この場合、開口部開閉扉26にエアー シリンダのロッド先端が取り付けられてロッドの所定ス トロークの伸縮によって開口22を開閉する。また、導 入口開閉扉27は2枚の扉で構成され、それぞれの扉に 対して、アーム一端がそれぞれ固定され、アーム中央部 でそれぞれ回動自在に軸支されたアーム(図示せず)の 他端にエアーシリンダのロッド先端が取り付けられてロ ッドの所定ストロークの伸縮によって導入口開閉扉27 をアーム(図示せず)を介して両開き状に両側で回動駆 動させて基板導入口24を開閉するようになっている。 このように、導入口開閉扉27を両開き用にしてそれぞ れの扉を開閉する場合、それぞれの扉の駆動用にはエア ーシリンダを2台設けるようにしてもよい。

10

【0041】さらに、搬送機構9は搬送ロボットで構成されており、複数の処理槽12~15の配設方向(X方向)に移動可能で複数の基板2を保持可能な一対の保持板29を有している。この一対の保持板29はそれぞれ、図2の紙面に直交する方向(図3のY方向)に伸びる各軸部材30(図3)にそれぞれ固定されており、これらの各軸部材30の軸芯をそれぞれ回動中心として互いに逆方向に回動自在に搬送機構本体9aに連結されている。また、この一対の保持板29にはそれぞれ、その対向した各内側に複数の基板2を所定間隔を空けてそれぞれ起立(垂直)姿勢で保持可能な保持用溝(図示せず)が複数形成されている。一対の保持板29の下端部を互いに内側に接近させて、複数の基板2をY方向に並べた状態でそれらの両側端面を両側からそれぞれ挟み込んで各保持用溝で受けて保持する。

【0042】さらに、これらの薬液槽12および水洗槽13と、薬液槽14および水洗槽15のそれぞれに、複数の基板2を搬送する各リフタ装置31がそれぞれ配設されている。図3に示すように、これらの各リフタ装置31は、基板保持用溝32aが複数形成され複数の基板2を下方から各基板保持用溝32aでそれぞれ受けて起立姿勢で保持する3本の保持アーム32と、この3本の保持アーム32が下端部分でL字状に接続された可動保持板33と、この可動保持板33と、この可動保持板33と、この可動部材34を上下動および水平動可能な可動部材34と、この可動部材34を上下動および水平動させる駆動手段(図示せず)とがそれぞれ配設されている。また、乾燥槽25にも、複数の基板2を搬送する各リフタ装置35が配設されており、このリフタ装置35はリフタ装置31と同様の構成をしている。

【0043】これらの各リフタ装置31,35の駆動手 段(図示せず)は、レールなどの案内部材(図示せず) に沿って可動部材34をレールなどの案内部材(図示せ ず)に沿って上下方向に移動させる垂直駆動ユニットを 有しており、例えばワイヤやベルトなどを駆動するプー リやロールなどをモータで回転駆動させてワイヤやベル トなどに取り付けられた可動部材34を上下動させるよ うにしてもよい。また、ピニオンおよびラックをモータ で駆動させて可動部材34を上下動させるようにしても よく、ボールねじとモータによって可動部材34を上下 動させるようにしてもよく、種々の駆動系が考えられ る。さらに、この各リフタ装置31の駆動手段(図示せ ず)は、レールなどの案内部材(図示せず)に沿って可 動部材34を上記垂直駆動ユニットと共に水平方向に移 動させる水平駆動ユニットを有しており、上記と同様に ボールねじなど種々の駆動系が考えられる。

【0044】各リフタ装置31の処理槽内への下降に連 動して導入口開閉扉27が開くように構成されていると 共に、処理槽内からの上昇に連動して導入口開閉扉27 が開くように構成されている。また、各リフタ装置31 の第2基板搬送エリア18内または第2基板搬送エリア 19内への下降に連動して開口部開閉扉26が開くよう に構成されていると共に、第2基板搬送エリア18内ま たは第2基板搬送エリア19内からの上昇に連動して開 口部開閉扉26が開くように構成されている。さらに、 リフタ装置35の乾燥槽25内への下降に連動して導入 口開閉扉28が開くように構成されていると共に、乾燥 槽25内からの上昇に連動して導入口開閉扉28が開く ように構成されている。つまり、これらの開口部開閉扉 26および導入口開閉扉27,28はそれぞれ複数の基 板2の通過時のみ開き、他は閉じているようになってい る。

【0045】さらに、各槽外郭部材16の上部側壁(図 2の処理槽開放口の高さ位置)にはそれぞれ各排気ダク ト37の排気口が処理槽幅方向に渡って長方形状にそれ ぞれ開口しており、それらの排気ダクト37の排気口は 流量調整バルブ38を介して排気ポンプ39に連通され ている。また、各第2基板搬送エリア18,19をそれ ぞれ覆っている各搬送エリア外郭部材21の側壁部には それぞれ、各排気ダクト37の排気口がリフタ装置31 の幅方向に渡って長方形状にそれぞれ開口しており、そ れらの排気ダクト37の排気口も流量調整バルブ38を 介して排気ポンプ39に連通されている。これらの各搬 送エリア外郭部材21の排気口は、薬液槽12、14の 上方近傍位置であって各第2基板搬送エリア18の最も 奥側の側壁に配設されている。これらの排気ダクト3 7、流量調整バルブ38および排気ポンプ39によって 排気手段23が構成されており、各槽外郭部材16内 (基板処理エリア17) および各搬送エリア外郭部材2

1内(第2基板搬送エリア18内)の適所に設けられた 50

この排気手段23による排気口からの排気によって、各搬送エリア外郭部材21の開口部開閉扉26が開いたり、各外郭部材16の基板導入口開閉扉27が開いても、この開口22や基板導入口24から外部の空気が流入することで、この開口22や基板導入口24を介して薬液槽12,14や、薬液の付いた複数の基板2からのヒューム(酸やアルカリなどが混ざった雰囲気)の外部への拡散が防止されるようになっている。

12

【0046】また、排気手段23は、分離部材としての 各搬送エリア外郭部材21の基板搬送用の開口22に対 して開閉可能なシャッタ手段を構成する開口部開閉扉2 6が開位置と閉位置に応じて排気ポンプ39の出力を高 排気出力と低排気出力に切り換え制御を行う制御手段

(図示せず)を有するようにしてもよい。つまり、この制御手段は、シャッタ手段が開口22を閉じている場合には、それをリミットスイッチ(図示せず)などで検出させて排気ポンプ39の出力を低排気出力とするように制御して省電力化し、基板搬送時などシャッタ手段が開口22を開けている場合には、それをリミットスイッチなどで検出させて排気ポンプ39の出力を高排気出力とするように制御してヒュームがクリーンな第1基板搬送エリア側に拡散しないように構成することもできる。

【0047】さらに、図3〜図5に示すように、これらのリフタ装置31と搬送機構9とは、並んで配設された複数の処理槽12〜15,25に対して同一側にそれぞれ配設されている。この場合に、これらのリフタ装置31と搬送機構9とはそれぞれ基板保持部分(保持板29や3本の保持アーム32)が前方(搬送方向に直交する方向)に突き出た片持ち構造をしている。

【0048】さらに、各搬送エリア外郭部材21の上方 の第1基板搬送エリア20を覆う更なるヒューム拡散防 止用の搬送エリア外郭部材40が設けられており、搬送 エリア外郭部材40内において複数の処理槽12~1 5, 25の配列された方向(X方向)に複数の基板2を 搬送させるための基板搬送ライン(第1搬送路)の空間 部分を構成している。この搬送エリア外郭部材40の側 壁には、搬送機構9の一対の保持板29と共にそれに保 持された複数の基板2の移動を許容するための開口41 が形成されており、この開口41を開閉するための開閉 扉42がには、その搬送エリア外郭部材40の側壁に沿 ってスライド自在に構成されている。この開閉扉42 は、通常は閉状態であり、搬送機構9の開口41に対す る通過時にのみ開状態となるように開閉駆動手段(図示 せず) で開閉駆動されるようになっている。この開閉駆 動手段は、例えば扉開閉用のシリンダと、搬送機構9を 検出する検出手段と、この検出手段で搬送機構9を検出 したときにシリンダを駆動させるように切り換える電磁 弁とを有している。

【0049】上記構成により、以下、その動作を説明する。

時)には低排気出力で排気して排気ポンプ39を3段階 の省電力駆動としてもよい。また、開口22および各基 板導入口24のうち少なくとも何れかの開放時に、高排

気出力で排気ポンプ39を駆動してその内部雰囲気を排 気し、開口22および基板導入口24の閉止時(エリア 内基板搬送時および基板処理時)には低排気出力で排気

14

内基板搬送時および基板処理時)には低排気出力で排気 して排気ポンプ39を2段階の省電力駆動としてもよ

【0053】さらに、所定時間後の薬液処理後、リフタ 装置31は、基板2を保持した保持アーム32を上昇さ せ、それに連動するように開閉扉27が仮想線で示すよ うに両側に開き、薬液槽12の上部開放口から基板導入 口24を通して基板2を保持した保持アーム32を薬液 槽12の上方まで上昇させ、水洗槽13のある水洗処理 部の上方位置まで横方向に水平移動させる。その後、リ フタ装置31は、薬液処理を済ませて基板2の表面に薬 液が付いた複数の基板2を保持アーム32と共に下降さ せ、この下降に連動して槽外郭部材16の基板導入口開 閉扉27が開き、その基板導入口24を通して複数の基 板2を保持した保持アーム32が水洗槽13の基板処理 エリア17内に導入される。この基板処理エリア17内 で、リフタ装置31は、水洗槽13の上部開放口から複 数の基板2をその薬液中に浸漬させ、複数の基板2の表 面に付着した薬液を洗い流す水洗処理を行う。

【0054】これらの一連の第2基板搬送エリア18内の基板搬送時や水洗処理時には上記と同様に、搬送エリア外郭部材21の開口22は開口部開閉扉26によって閉じられていると共に、この薬液槽12および水洗槽13上の各槽外郭部材16の基板導入口24もそれぞれ、各基板処理エリア17内への基板導入時以外は各基板導入口開閉扉27によってそれぞれ閉じられているが、このような場合にも、薬液槽12からの一連の第2基板搬送エリア18内の基板搬送時には、薬液の付いた複数の基板2からのヒュームを排気するべく、高排気出力で排気ポンプ39を駆動してその内部雰囲気を排気するようにしてもよい。

【0055】さらに、所定時間後の水洗処理後、リフタ装置31は、基板2を保持した保持アーム32を上昇させ、それに連動するように開閉扉27を両側に開き、水洗槽13の上部開放口から基板導入口24を通して基板2を保持した保持アーム32を上昇させ、さらに、その上昇に連動するように開口部開閉扉26を開き、搬送エリア外郭部材21の開口22を通して基板2を保持した保持アーム32を基板受渡位置まで上昇させる。

【0056】この搬送エリア外郭部材21で覆われた第 1の処理ユニットにおける基板受液位置では、搬送機構 9の一対の保持板29が垂直方向の姿勢で待機してお り、基板2を保持した保持アーム32を一対の保持板2 9の間に到着させた後に、一対の保持板29の下部側を それぞれ内側に回動させて、複数の基板2の両側端面を

【0050】まず、搬送機構9は、搬出入部(図示せ ず)から基板2を受け取って第1の処理ユニットのある 第1基板搬送エリア18の開口22の上方の基板受渡位 置まで第1基板搬送エリア20内の搬送路をその搬送路 方向 (X方向) に沿って搬送する。この基板受渡位置に おいて、図2に示すように、搬送機構9の一対の保持板 29はそれぞれ、それらの内側の複数の保持用溝で、起 立姿勢の複数の基板2の両側端面を両側からそれぞれ挾 み込んで受けて保持している。これに対して、リフタ装 置31がその基板受渡位置まで上昇してきて、その下方 部に設けられた3つの保持アーム32の上側の複数の各 保持溝で、搬送機構9に保持されている複数の基板2を 下方から受ける。その後、搬送機構9の一対の保持板2 9をそれぞれ垂直方向になるようにそれぞれ回動させ て、搬送機構9による複数の基板2への保持を解除し、 リフタ装置31の3つの保持アーム32上への複数の基 板2の受渡しを完了する。

【0051】次に、リフタ装置31は複数の基板2を3つの保持アーム32上の複数の各保持溝で保持した状態で下降し始めると、この下降に連動して搬送エリア外郭20部材21の開口部開閉扉26が開き、その開口22を通して複数の基板2と共にリフタ装置31が第2基板搬送エリア18内で、リフタ装置31は複数の基板2と共に、薬液処理部の上方位置まで横方向に水平移動した後に、薬液槽12のある薬液処理部内に向けて下降し始める。この下降に連動して槽外郭部材16の基板導入口開閉扉27が開き、その基板導入口24を通して複数の基板2を保持した3つの保持アーム32が基板処理エリア17内に入って、さらに、薬液槽12の上部開放口から基板2を保持した3つの保持アーム32をその薬液中に浸漬させ、その状態で所定時間放置して複数の基板2の表面に所定の薬液処理を施す。

【0052】これらの一連の第2基板搬送エリア18内 の基板搬送時や薬液処理時には、搬送エリア外郭部材2 1の開口22は開口部開閉扉26によって閉じられてい ると共に、この薬液槽12および水洗槽13上の各槽外 郭部材16の基板導入口24もそれぞれ、その基板処理 エリア17内への基板導入時以外は各基板導入口開閉扉 27によってそれぞれ閉じられている。また、排気手段 40 23は、常に一定の排気能力で排気するようにしてもよ いが、この場合には、その開口22および各基板導入口 24の開放時(エリア間の基板搬送時)にも外部にヒュ ーム拡散がないような高排気能力でなければならない。 このため、開口22および各基板導入口24の開放時に 高排気出力で排気ポンプ39を駆動してその内部雰囲気 を排気し、開口22および各基板導入口24のうち何れ か一方の開放時に、中排気出力で排気ポンプ39を駆動 してその内部雰囲気を排気し、開口22および基板導入 口24の閉止時(エリア内基板搬送時および基板処理

両側からそれぞれ挾み込んで各保持用溝でそれぞれ受け て保持する。

【0057】さらに、リフタ装置31を保持アーム32 と共に下方に退避させた後に、搬送機構9の一対の保持 板29は複数の基板2を保持した状態で、次の第2の処 理ユニットのある第2基板搬送エリア19の開口22の 上方の基板受渡位置まで第1基板搬送エリア20内の搬 送路をその搬送路方向(X方向)に沿って搬送する。こ のとき、搬送機構9の一対の保持板29は、それらの内 側の複数の保持用溝で、起立姿勢の複数の基板2の両側 端面を両側からそれぞれ挾み込んで受けて保持してい る。これに対して、第2の処理ユニットのリフタ装置3 1が上昇してきて、その下方部に設けられた3つの保持 アーム32の上側の複数の各保持溝で、一対の保持板2 9に保持されている複数の基板2を下方から受ける。そ の後、一対の保持板29をそれぞれ垂直方向になるよう に回動させて、一対の保持板29の複数の基板2への保 持を解除し、搬送機構9の一対の保持板29から第2の 処理ユニットのリフタ装置31への複数の基板2の受渡 しが完了する。

【0058】さらに、第2の処理ユニットのリフタ装置31に受け渡された複数の基板2は、そのリフタ装置31によって第2基板搬送エリア19内に導入されることになる。また、一方、空の搬送機構9は、搬出入部に戻って基板2を受け取り、第1第1の処理ユニットの搬送エリア外郭部材21の開口22の上方の基板受渡位置まで複数の基板2を搬送して、第2基板搬送エリア19内に導入するべくリフタ装置31に複数の基板2の受渡しを行う。

【0059】また、このように、第2基板搬送エリア18,19内にそれぞれ導入された複数の基板2はそれぞれ、その後の第1の処理ユニットおよび第2の処理ユニットにおける各基板搬送および扉開閉さらに排気などの各動作は、上記した第1の処理ユニットにおける薬液処理および水洗処理のための各動作と同様に行われる。

【0060】さらに、第2の処理ユニットのリフタ装置31は、所定時間後の水洗処理後の複数の基板2を上昇させ、それに連動するように開閉扉27が開き、水洗槽15の上部開放口からその基板導入口24を通して基板2を保持した保持アーム32を上昇させ、その上昇に連動するように開口部開閉扉26を開き、搬送エリア外部部材21の開口22を通して基板2を保持した保持アーム32を第2の処理ユニットの基板受渡位置まで上昇記せる。その基板受渡位置では、搬送機構9が一対の保持板29をそれぞれ垂直方向の姿勢で待機しており、基板2を保持した保持アーム32を一対の保持板29の間の基板受渡位置に到着させた後に、一対の保持板29の下端側をそれぞれ内側に回動させて、複数の基板2の両側端面を両側からそれぞれ挟み込んで各保持用溝で受けて保持することで基板2の搬送機構9への受渡しを行う。

【0061】その後、搬送機構9の一対の保持板29 は、乾燥槽25のリフタ装置35に対して第2の処理ユ ニットの処理が終了した複数の基板2を受け渡す。ま た、第1の処理ユニットのリフタ装置31から一対の保 持板29に対して第1の処理ユニットの処理が終了した 複数の基板2を受け取ってその一対の保持板29から第 2の処理ユニットのリフタ装置31に複数の基板2を受 け渡す。さらに、第2の処理ユニットのリフタ装置31 に受け渡された複数の基板2は第2基板搬送エリア19 内に導入されると共に、搬送機構9は、搬出入部に戻っ て基板2を受け取り、第1の処理ユニットの開口22の 上方の基板受渡位置まで基板2を搬送して、第1の処理 ユニットのリフタ装置31に複数の基板2の受渡しを行 う。一方、乾燥処理部のリフタ装置31によって複数の 基板2を保持アーム32と共に下降させ、その下降に連 動させて開閉扉28を開いて乾燥槽25内に複数の基板 2が導入されて乾燥処理が行われる。

【0062】このようにして、第2基板搬送エリア18,19、乾燥処理部内にそれぞれ導入された複数の基板2はそれぞれ、第1の処理ユニットおよび第2の処理ユニット、乾燥処理部における各基板搬送および扉開閉さらに排気などの各動作が行われる。

【0063】さらに、リフタ装置35によって再び、乾燥槽25内からその上方の基板受液位置まで乾燥処理後の複数の基板2を上昇させて搬送機構9の一対の保持板29間に受渡し、その搬送機構9によって乾燥処理後の複数の基板2を搬出入部(図示せず)との基板受液位置まで各処理部の配設方向(X方向)に沿って複数の処理済みの基板2を搬送して、搬出入部にその複数の処理済みの基板2を受け渡す。

【0064】このように、搬送機構9の一対の保持板29は、乾燥槽25のリフタ装置35に対して第2の処理ユニットの処理が終了した複数の基板2を受け渡すと共に、第1の処理ユニットのリフタ装置31から第1の処理ユニットの処理が終了した複数の基板2を受け取ってその一対の保持板29から第2の処理ユニットのリフタ装置31に複数の基板2を受け渡された複数の基板2は第2基板搬送エリア19内に導入されると共に、搬送機構9は、搬出入部に戻って複数の基板2を受け取り、第1の処理ユニットの開口22の上方の基板受渡位置まで基板2を搬送して、第1の処理ユニットのリフタ装置31に複数の基板2の受渡しを行う。以上の各動作が、上記したように順次繰り返されて複数の基板2に対して所定の処理が行われることになる。

【0065】以上のように、薬液からのヒュームが拡散 してくる各処理部側の第2基板搬送エリア18,19を それぞれ分離部材としての搬送エリア外郭部材21でそ れぞれ覆うと共に、各搬送エリア外郭部材21の開口2 2から薬液のヒュームが外側の第1基板搬送エリア20 内に拡散し難いように、水洗槽13,14にそれぞれ対応した位置にのみ開口22を設けて、できる限り小さな開口22としたため、排気手段23の排気能力を大幅に小さく(例えば80パーセント小さく)しても、各搬送エリア外郭部材21の外側の第1基板搬送エリア20へのヒュームの拡散が防止可能であることから、排気手段23がより小型化可能で省電力で省スペース、しかも、より静音の基板処理装置とすることができる。

【0066】また、各搬送エリア外郭部材21の基板搬送用の開口22を開閉するシャッタ手段を設けるように 10 したため、排気能力がより小さい排気手段23であっても、薬液から出たヒュームの各搬送エリア外郭部材21 の外部 (第1基板搬送エリア20内) への拡散を防止することができる。

【0067】さらに、薬液の付いた複数の基板2が基板処理エリア17から外側に取り出される第2基板搬送エリア18,19内の薬液処理部の上方位置が最もヒューム濃度が濃く、そのヒューム濃度の濃い位置から離れた水洗処理部の上方の各搬送エリア外郭部材21に開口22をそれぞれ設けるようにしたため、薬液から出たヒュームが外側の第1基板搬送エリア20内に拡散されにくく、排気能力のより小さい排気手段23で済ませることができる。

【0068】さらに、第2基板搬送エリア18,19内の薬液処理部の上方位置が最もヒューム濃度が濃く、薬液処理部の近傍に排気手段23の排気口を設けるようにしたため、排気手段23で排気口からヒューム濃度の濃い雰囲気を効率よく排気することができて、排気能力のより小さい排気手段23でも、よりヒューム濃度を希薄にすることができる。

【0069】さらに、搬送エリア外郭部材21の開口22がシャッタ手段によって開いているときには高排気出力で搬送エリア外郭部材21内(第2基板搬送エリア18,19)のヒュームを排気し、搬送エリア外郭部材21の開口22がシャッタ手段によって閉じているときには低排気出力で搬送エリア外郭部材21内(第2基板搬送エリア18,19)のヒュームを排気するように切り換え可能にしたため、シャッタ手段の閉時には、省電力で小駆動音(静音)とすることができると共に、シャッタ手段の開時にはヒュームの搬送エリア外郭部材21の40外部の第1基板搬送エリア20内への拡散をさらに抑制することができる。

【0070】なお、本実施形態では、基板処理エリア1713よび第2基板搬送エリア18,19内の雰囲気を排気手段23の排気ダクト37を介して排気するように構成し、排気手段23の排気ポンプ39の排気出力制御は、開口22および各基板導入口24の開閉に応じて行うと共に、薬液槽12,14から水洗槽13,15に至る一連の第2基板搬送エリア18,19内の基板搬送時に、薬液の付いた複数の基板2からのヒュームを排気す

18

るべく、排気出力を高めるように行ったが、これに限ら ず、薬液槽12,14と水洗槽13,15と第2基板搬 送エリア18,19とでそれぞれ異なる排気手段を設 け、それらの排気手段を上記のように排気出力制御して もよい。この場合に、薬液槽12,14と水洗槽13, 15の基板処理エリア17内の排気出力制御ではヒュー ム自体が異なりそれに応じた排気出力制御(例えばヒュ ーム濃度が薄ければ排気出力も低出力でよい)とするよ うに、それぞれ異なる各排気手段を制御することができ る。また、基板処理エリア17内や第2基板搬送エリア 18,19内の排気出力制御では、開口部開閉扉26や 基板導入口開閉扉27が開いたときに最も高い排気出力 とし、その後は、ヒューム拡散がない程度に徐々に出力 低下させるようにし、また、第2基板搬送エリア18, 19での排気出力制御で、薬液槽12,14から第2基 板搬送エリア18, 19内に取り出されたときに最も高 い排気出力とし、その後は、ヒューム拡散がない程度に 徐々に出力低下させるように、それぞれ異なる各排気手 段を制御することができる。

【0071】また、本実施形態では、複数の基板2を一括して処理するバッチ式の基板処理装置に、各処理部側の基板搬送エリアを分離部材で覆い、その分離部材に、できる限り小さな開口を設ける本発明を適応した場合について説明したが、基板2を一枚づつ処理する枚様式の基板処理装置にも本発明は適用可能である。

[0072]

【発明の効果】以上のように本発明の請求項1によれば、薬液等からのヒュームが拡散してくる各処理部側の基板搬送エリアを分離部材で覆うと共に、その分離部材の開口から薬液等のヒュームが外側に拡散し難いように、一の処理部に対応した位置にのみ開口を設けて、できる限り小さな開口としたため、排気手段の排気能力が大幅に小さくなっても、分離部材の外側へのヒュームの拡散が防止可能であることから、排気手段がより小型化可能で省電力で省スペース、しかも、より静音の基板処理装置とすることができる。

【0073】また、本発明の請求項2によれば、分離部材の基板搬送用の開口を開閉するシャッタ手段を設けるようにしたため、排気能力がより小さい排気手段で、薬液等から出たヒュームの分離部材外部への拡散を防止することができる。

【0074】さらに、本発明の請求項3によれば、薬液の付いた基板が基板処理エリアから外側に取り出される 薬液処理部の上方位置が最もヒューム濃度が濃く、その ヒューム濃度の濃い位置から離れた水洗処理部の上方の 分離部材に開口を設けるようにしたため、薬液から出た ヒュームが外側に拡散されにくく、排気能力のより小さ い排気手段で済ませることができる。

【0075】さらに、本発明の請求項4によれば、薬液処理部の上方位置が最もヒューム濃度が濃く、薬液処理

20

部の近傍に排気口を設けるようにしたため、排気手段で 排気口からヒューム濃度の濃い雰囲気を効率よく排気す ることができて、排気能力のより小さい排気手段でも、 よりヒューム濃度を希薄にすることができる。

【0076】さらに、本発明の請求項5によれば、分離部材の開口がシャッタ手段によって開いているときには高排気出力で分離部材内のヒュームを排気し、分離部材の開口がシャッタ手段によって閉じているときには低排気出力で分離部材内のヒュームを排気するように切り換え可能にしたため、シャッタ手段の閉時には、省電力で10小駆動音(静音)とすることができると共に、シャッタ手段の開時にはヒュームの分離部材外部への拡散をさらに抑制することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施形態の基板処理装置の概略要部 構成を示す斜視図である。

【図2】図1の基板処理装置のAA断面部分を背面から見た概略要部構成図である。

【図3】図2のリフタ装置と搬送機構との基板受渡し状態の概略構成を示す斜視図である。

【図4】図2のリフタ装置と搬送機構との基板受渡し状態の概略構成を示す側面図である。

【図5】従来の基板処理装置における要部の概略構成を 示す模式図である。

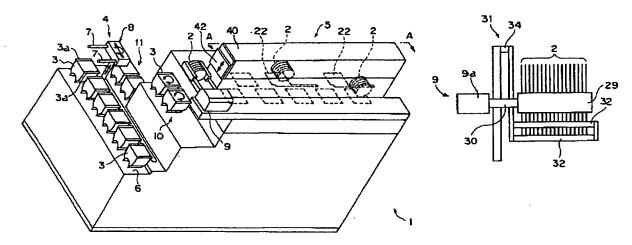
【図6】図5のリフタ装置と搬送ロボットとの基板受渡 し状態の概略構成を示す側面図である。

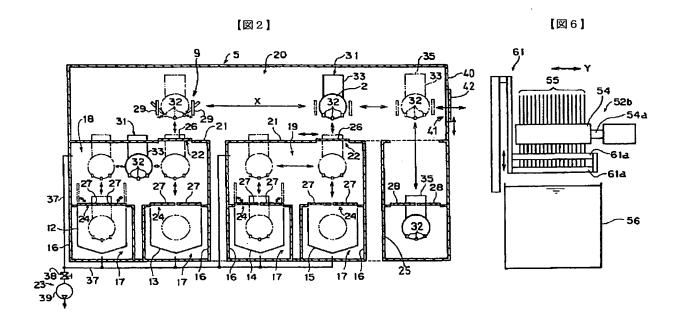
【符号の説明】

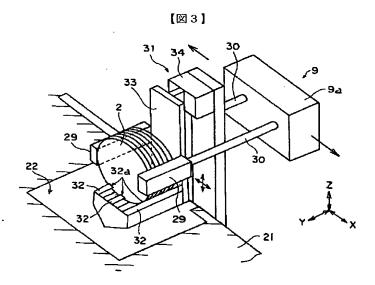
- 1 基板処理装置
- 2 基板
- 5 基板処理ユニット
- 9 搬送機構
- 12,14 薬液槽
- 13, 15 水洗槽
- 16 槽外郭部材
- 17 基板処理エリア
- 18,19 第2基板搬送エリア
 - 20 第1基板搬送エリア
 - 21,40 機送エリア外郭部材
 - 22,41 開口
 - 23 排気手段
 - 24 基板導入口
 - 25 乾燥槽
 - 26 開口部開閉扉
 - 27, 28 導入口開閉扉
 - 29 保持板
- 20 31,35 リフタ装置
 - 32 保持アーム
 - 37 排気ダクト
 - 38 流量調整バルブ
 - 39 排気ポンプ
 - 42 開閉扉

【図1】

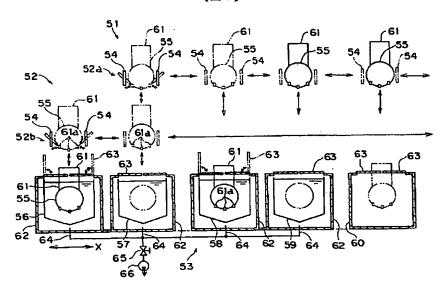
【図4】











フロントページの続き

(51) Int.C1.6

識別記号

FΙ